

求人募集要項：半導体レーザーチップエンジニア

■職務名称：半導体レーザーチップエンジニア

■配属部門：レーザーデバイス事業部

■募集理由：当社はデータ通信、LSI チップ間通信、LiDAR など、今後の情報化社会の根幹を支えるシリコンフォトニクス技術の核となる量子ドットレーザ、多様な工業製品の精緻な切削や加工に欠かせない超短パルス DFB レーザ、およびフローサイトメータや蛍光顕微鏡用光源などに使用され高度な医療を支える小型可視光レーザなど、当社独自の技術を進化させた社会貢献度の非常に高い様々な半導体レーザー製品を開発、販売しております。今後更なる売上拡大を目指し、波長ラインナップの拡充、高温・高出力動作チップ等の新規開発や既存レーザの特性改善を行い、より一層社会貢献できる製品を市場に提供するために、その設計・開発を担っていただくプロフェッショナルを募集します。

■開始時期：2023年3月頃から就業可能な方（早い方がよい）

■就業場所：川崎市川崎区南渡田町1-1 京浜ビル

■想定年収：800万円以上（処遇につきましては入社後の実績により適切に見直しを行います）

■雇用形態：正社員

■業務内容：

・シリコンフォトニクス用 1300nm 帯量子ドットレーザ、加工用 1020-1180nm DFB レーザおよびバイオメディカル用 532-594nm 小型可視レーザの高性能化・高機能化のためのチップ開発
具体的業務は以下になります。

（1）シリコンフォトニクス用 1300nm 帯量子ドットレーザ

シリコンフォトニクス用光源として FP・DFB レーザともに高温・広温度範囲での高出力化が求められており、そのチップの開発・設計業務を実施いただきます。

（2）加工用 1020-1180nm DFB レーザ

ナノ秒パルス駆動時の高出力化やピコ秒パルスレーザの更なる短パルス化を実現するチップの開発・設計業務を実施いただきます。

（3）バイオメディカル用 532-594nm 小型可視レーザ

波長ラインナップの拡充や高出力化・高信頼性チップの開発・設計業務を実施いただきます。

- ・半導体レーザーチップ設計、ウェハプロセス設計および評価
- ・チップファンドリへの指示
- ・顧客からの問合せに対する技術対応

■スキル／経験：

【必須要件】

- ・半導体レーザーチップの設計・評価の経験および知識

- ・ビジネス英会話（目安：TOIEC 600 点以上）

【人物像】

- ・新しい技術に興味を持ち、自ら考え、自ら行動できる人
- ・強い意思を持って目標達成できる人
- ・開発、生産、営業メンバーとのチームワークを大切にしながら業務を遂行できる人

以上